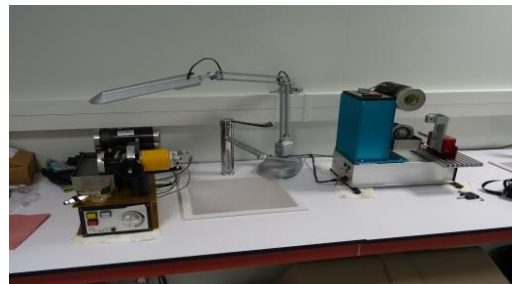


Découpe tous substrats avec une précision de 10 μ m

Equipements de découpe à disque et à fil (horizontale et verticale) à liant résine (poudre de diamant)



VOS BESOINS

- Découper avec précision des cristaux plans nus ou déjà structurés (dépôt ou microcomposants).

COMPETENCES PROCHES

- Après découpe, il est possible de fixer et de connecter électriquement les composants sur carte PCB.
- Pour le cas du silicium, il est possible d'uniquelement graver en surface avec une pointe diamant sur "blue tape" pour un clivage ultérieur.
- [Procédés de micro et nanofabrication](#)

NOS SOLUTIONS

- Scie à disque pour tout matériaux jusqu'à 4".
- Scie à fil horizontale à liant résine pour une précision de positionnement maximum jusqu'à 3".
- Scie à fil verticale à liant résine pour des contraintes mécaniques minimum convenant aux substrats fins et fragiles jusqu'à 3".
- "Wafer scribe" pour les substrats silicium jusqu'à 6".

NOS REFERENCES

MOTS CLES

Découpe, scribbling, microcomposants

CONTACTS

Contact de l'équipe

✉ juan-carlos.rojas-sanchez@univ-lorraine.fr
☎ + 33 3 72 74 25 78

Contact TTO service dédié à la relation entreprises

✉ ijl-tto@univ-lorraine.fr
☎ +33 3 72 74 26 04